

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle
Bureau international



(10) Numéro de publication internationale
WO 2025/153203 A1

(43) Date de la publication internationale
24 juillet 2025 (24.07.2025)

WIPO | PCT

- (51) Classification internationale des brevets :
H01L 21/02 (2006.01) H01L 21/762 (2006.01)
- (21) Numéro de la demande internationale :
PCT/EP2024/081619
- (22) Date de dépôt international :
08 novembre 2024 (08.11.2024)
- (25) Langue de dépôt : français
- (26) Langue de publication : français
- (30) Données relatives à la priorité :
FR2400567 19 janvier 2024 (19.01.2024) FR
- (71) Déposant : SOITEC [FR/FR] ; PARC TECHNOLOGIQUE DES FONTAINES, CHEMIN DES FRANQUES, 38190 BERNIN (FR).
- (72) Inventeurs : NOURI, Lamia ; C/O SOITEC, PARC TECHNOLOGIQUE DES FONTAINES, CHEMIN DES FRANQUES, 38190 BERNIN (FR). VEYTIZOU, Christelle ; C/O SOITEC, PARC TECHNOLOGIQUE DES FONTAINES, CHEMIN DES FRANQUES, 38190 BERNIN (FR).

- (74) Mandataire : IP TRUST ; 2 rue de Clichy, 75009 PARIS (FR).
- (81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK,

(54) Title: CARRIER COMPRISING A LAYER FOR TRAPPING ELECTRICAL CHARGES FOR A COMPOSITE SUBSTRATE

(54) Titre : SUPPORT COMPRENANT UNE COUCHE DE PIEGEAGE DE CHARGES ELECTRIQUES POUR UN SUBSTRAT COMPOSITE

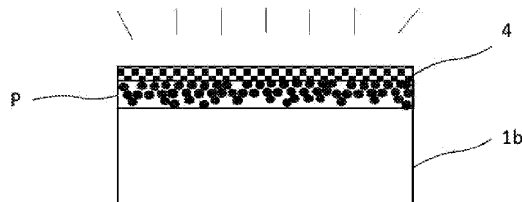


Figure 3c

(57) Abstract: The invention relates to a method for preparing a carrier (1) for a composite substrate (S), which method comprises forming a superficial porous layer (P) on a first face (1c) of the carrier (1), and dispensing a viscous solution comprising a solvent and a precursor of a filler material on the first face (1c) of the carrier (1) so as to absorb at least some of the viscous solution in open pores of the superficial porous layer (P). In a fourth step, the carrier (1) is heat-treated to transform the viscous solution present in the open pores in order to fill the open pores with the filler material.

(57) Abrégé : L'invention porte un procédé de préparation d'un support (1) pour un substrat composite (S) comprenant la formation d'une couche poreuse superficielle (P) sur une première face (1c) du support (1), la dispense d'une solution visqueuse comprenant un solvant et un précurseur d'un matériau de remplissage sur la première face (1c) du support (1) de sorte à absorber une partie au moins de la solution visqueuse dans des pores ouverts de la couche poreuse superficielle (P). Dans une quatrième étape, on traite thermiquement le support (1) pour transformer la solution visqueuse présente dans les pores ouverts pour qu'ils soient emplis du matériau de remplissage.

[Suite sur la page suivante]

WO 2025/153203 A1

SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ,
GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée:

— avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))